

此膏适用于 Tin Cream 及 BGA 等元件的焊接。

产品特点

100 % 不含铅，符合 RoHS 标准 !!

具有良好的润湿性和流动性。

适用于各种 PCB 材料，如 FR-4、BT、陶瓷等。

适用于各种元件，如 BGA、SMD、QFN 等。

适用于 PC、MC、MCU 等元件的焊接。

规格

型号 : BST-510

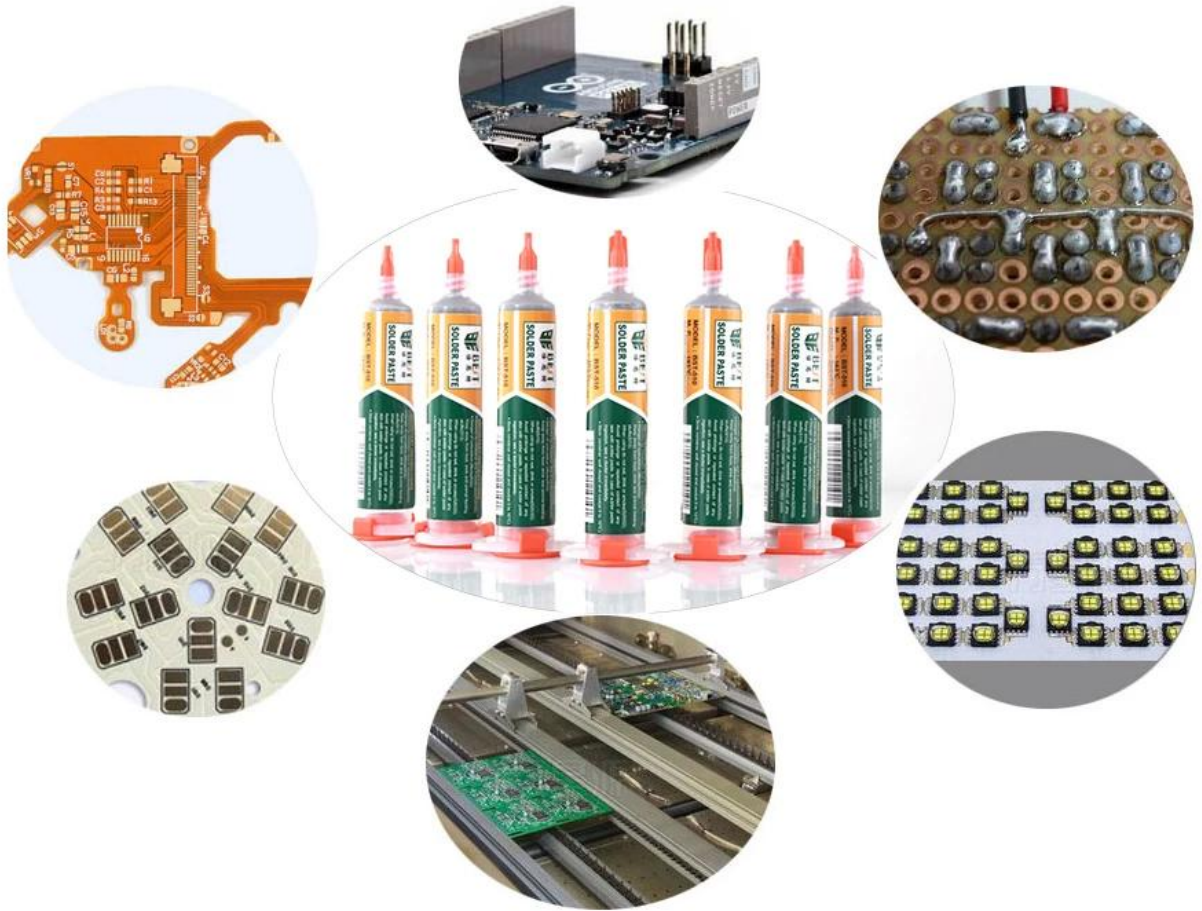
温度 : 183 °C

容量 : 10cc

重量 : 38g

成分 : Sn63 %

PRODUCT USAGE



PRODUCT SIZE





Brand: BEST

Model Number:510

Melting point:183°C

Ingredients: Sn63% Pb37

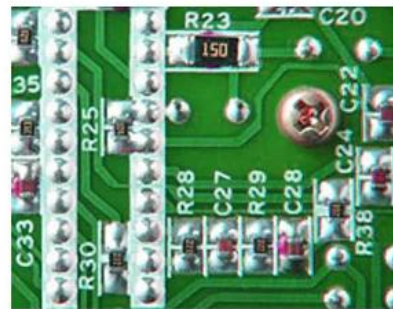
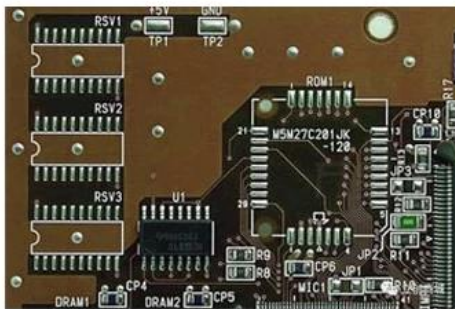
Volume:10cc

Weight: 38g

Having a large insulation resistance does not corrode the PCB, and the requirements for no-cleaning can be achieved.



High impedance, full and bright solder, low residue



PRODUCT PHOTOGRAPH



